

**Allgemein**

Produktspezifische Kenndaten finden Sie zu den jeweiligen Artikel unter der Rubrik „Technische Daten“!  
Darüber hinausgehende kundenspezifische Beratung und Lösungsvorschläge werden von der Konstruktions- und Entwicklungsabteilung der Fa. Fischer Elektronik GmbH & Co. KG unterstützt.

**Oberfläche – Galvanoverfahren**

Generell werden alle Kontakte mit einer Nickelsperrschicht (1,3-3 µm) beschichtet, bevor sie verzinnt oder vergoldet werden.

Dies gilt auch für selektiv vergoldete Kontakte.

Bei den selektiv beschichteten Kontakten wird erst der gesamte Kontakt, inkl. Trägerband, vernickelt.

Anschließend wird die Kontaktseite vergoldet und die Lötseite verzinnt, in der Regel im „Tauchverfahren“ oder im „Brushverfahren“.

Abhängig von der Gesamtkontaktlänge ist dann der mittlere Bereich ausschließlich vernickelt.

Die Schichtstärke der Vergoldung beträgt mind. 0,2 µm Au, die Schichtstärke der Verzinnung beträgt 4-6 µm!

Andere Schichtstärken sind auf Anfrage möglich.

Die Verzinnung wird mit Reinzinn ausgeführt. Die Lötbarkeit wird auf mind. 1 Jahr nach Auslieferung garantiert.

Bei sachgerechter Lagerung in geschlossener Verpackung kann diese Zeit deutlich erhöht werden.

**Maßtoleranz**

Grundsätzlich liegt die DIN ISO 2768m allen Produkten zu Grunde! Darüber hinaus sind folgende Ergänzungen zu beachten:

- Längentoleranz von Stiftkontakte beträgt  $\pm 0,2$  mm.
- Rastertoleranz beträgt  $\pm 0,03$  mm, die Gesamtastertoleranz über 36 Pole  $\pm 0,2$  mm
- Formtoleranz der Isolierkörper ist auf  $\pm 0,15$  mm definiert
- Polzahltrennung mittels Schneiden:  $+0,6$  mm/ $-0,3$  mm
- Polzahltrennung mittels Sägen:  $+0,1$  mm/ $-0,4$  mm (kein Standard)
- Koplanarität von SMD-Lötanschlüssen max. 0,15 mm bei einer Leistenlänge von 50 mm nach DIN EN 61760-1

**Gütestufe in Anlehnung an die DIN 41652**

Abhängig der Schichtstärke der Vergoldung können die Kontakte auch in Gütestufen klassifiziert werden.

Hierbei wird in drei Gütestufen unterschieden:

Gütestufe 1: mind. 500 Steckzyklen, Schichtstärke entsprechend mind. 1,2 µm Au

Gütestufe 2: mind. 200 Steckzyklen, Schichtstärke entsprechend mind. 0,75 µm Au

Gütestufe 3: mind. 50 Steckzyklen, Schichtstärke entsprechend mind. 0,2 µm Au

Kontakte verzinnt: bei der Anwendung von „Zinn auf Zinn“ ist nur eine Steckzyklenzahl von 1 bis max. 10 Steckzyklen möglich.

**Präzisionsbuchsenkontakte**

Diese Kontakte sind zweiteilig und bestehen aus einer Hülse (Drehteil) und einem Federteil (Stanzteil).

Das Federteil (Clip) ist immer vergoldet (je nach Artikel mind. 0,2 µm Au oder mind. 0,75 µm Au).

Die Hülse ist in der Regel verzinnt, bei einigen Varianten auch wahlweise vergoldet (mind. 0,2 µm Au).

**Kontaktträgerwerkstoff aus hochtemperaturbeständigem Kunststoff**

Die verwendeten Kunststoffe bei den Buchsen- und Stiftleisten sind überwiegend hochtemperaturbeständig, d.h. sie sind zum Einsatz für Reflowlötverfahren geeignet.

Dies gilt in erster Linie für SMD-Bauteile genauso wie für Steckerleisten die für das Wellenlötverfahren ausgelegt sind.

Im Katalog sind diese Produkte auf der jeweiligen Seite in der Kopfzeile mit dem „260 °C“ Logo gekennzeichnet.